

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-13

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资总额不超过 100.00 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2026 年公司拟向银行申请综合授信额度情况

2026 年度公司及控股子公司拟向金融机构、类金融机构申请累计总额不超过 100.00 亿元人民币（或等值外币）的融资授信额度。

上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、供应链融资、跨境融资等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

股东会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权董事长与金融机构及类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度有效期为：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日